



BỘ TÀI CHÍNH
CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20863 /TB-CHQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO
Về kết quả xác định trước mã số

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 06 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 167/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 04 năm 2018 và Thông tư số 121/2025/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 06 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở Đơn đề nghị xác định mã số số 260701-08/HST ngày 01/7/2026 của Công ty TNHH Hwaseung Tech Vina (MST: 2500626462) và hồ sơ kèm theo;

Cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Đồng lá mỏng, bằng đồng tinh luyện, ký hiệu HSF-USB3-3.0

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Đồng lá mỏng (bằng đồng tinh luyện) chắn nhiễu điện từ, dạng cuộn. Được cấu tạo 3 lớp chính: lớp đồng phủ mạ niken ở giữa là lớp chính dẫn điện và chắn nhiễu điện từ, lớp cách điện là nhựa epoxy + carbon và lớp keo kết dính epoxy không dẫn điện. Hai lớp phụ là

màng nhựa PET để bảo vệ bề mặt trên dưới của sản phẩm khi vận chuyển, chống tác động ngoại lực bên ngoài trong quá trình thao tác sản xuất. Chiều dày sản phẩm: 10μm (không tính lớp bồi), chiều rộng: 250mm-200mm, chiều dài từ 10m đến 500m. Công dụng: dùng làm lớp dẫn điện và che chắn nhiễu điện từ (EMI), sau đó được gắn lên module mặt trước của bản mạch in điện tử (PCB/FPCB).	
Ký, mã hiệu, chủng loại: HSF-USB3-3.0 (EMI Shielding Film)	Nhà sản xuất: GUANGZHOU FANGBANG ELECTRONICS CO., LTD (P.R.C)
2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số: Theo hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, thông tin mặt hàng như sau: - Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: Được cấu tạo 3 lớp chính và 2 lớp phụ (màng nhựa PET để bảo vệ bề mặt trên dưới của sản phẩm khi vận chuyển). Trong đó 3 lớp chính bao gồm: (1) Lớp Insulation (lớp cách điện): + Epoxy resin (CAS: 61788-97-4): 24,7%. + Carbon (CAS: 7440-44-0): 6,1%. (2) Lớp Metallic (lớp dẫn điện và chắn nhiễu điện từ): + Nickel (CAS: 7440-02-0): 7,5%. + Copper (CAS: 7440-50-8): 47,1%. (3) Lớp Adhesive (lớp keo không dẫn điện): + Epoxy resin (CAS: 61788-97-4): 14,6%. - Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Cuộn đồng lá mỏng này khi đưa vào dây chuyền sản xuất được tời ra cho vào mắt cắt và máy dập để cắt dập theo hình dáng kích thước và đặc thù riêng của từng loại bản mạch điện tử. Để sử dụng cần loại bỏ hết bavia, rồi bóc 2 lớp màng PET đi và chỉ giữ lại lớp đồng mạ niken ở giữa, lớp cách điện là nhựa epoxy + carbon và lớp keo kết dính epoxy không dẫn điện, sau đó dán hoặc gắn lên module mặt trước của bản mạch, trong đó lớp đồng đóng vai trò dẫn điện chính chắn nhiễu điện từ, lớp cách điện chống dính epoxy + carbon và lớp keo liên kết chỉ mang tính hỗ trợ kỹ thuật, không quyết định bản chất hàng hóa. - Hàm lượng tính trên trọng lượng: Hàng hóa được cấu tạo bởi 03 lớp chính như sau: (1) Lớp Insulation (lớp cách điện): + Epoxy resin (CAS: 61788-97-4): 24,7%. + Carbon (CAS: 7440-44-0): 6,1%. Có tác dụng cách điện, bảo vệ bề mặt, không tham gia dẫn điện. (2) Lớp Metallic (lớp dẫn điện và chắn nhiễu điện từ): + Nickel (CAS: 7440-02-0): 7,5%.	

+ Copper (CAS: 7440-50-8): 47,1%.

Mạ niken có tác dụng tăng độ ổn định bề mặt, tăng khả năng chống ăn mòn, khả năng che chắn, tối ưu hoá độ dẫn điện cho lớp đồng. Đồng tinh luyện lá mỏng có tác dụng dẫn điện cực tốt và chắn nhiễu điện từ cho bản mạch in điện tử.

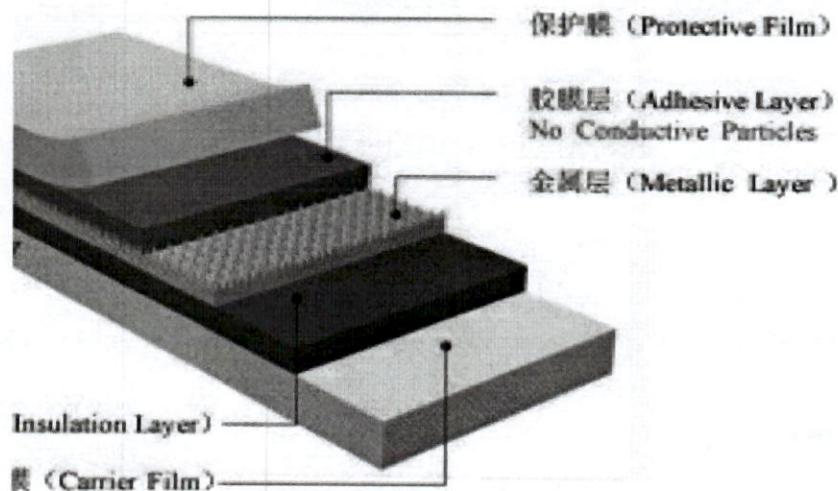
(3) Lớp Adhesive (lớp keo không dẫn điện):

+ Epoxy resin (CAS: 61788-97-4): 14,6%.

Có tác dụng gắn kết, chống ăn mòn, chống ẩm bề mặt và trợ cứng cho lớp đồng lá mỏng khỏi tác động ngoại lực.

Ngoài 3 lớp chính thì có 2 lớp bồi: Protective Film (Lớp bồi mặt trên) và Carrier Film (Lớp bồi mặt dưới), là màng film PET có tác dụng bảo vệ bề mặt khi vận chuyển, trợ cứng cho lớp đồng lá mỏng chống tác động ngoại lực trong quá trình sản xuất.

- Thông số kỹ thuật: Dạng cuộn, bề mặt được làm phẳng, kích thước: chiều dày 10 μ m (không gồm lớp bồi nhựa PET); chiều rộng 250mm-200mm, chiều dài từ 10m đến 500m.



- Quy trình sản xuất: theo quy trình của Nhà sản xuất.

(1) Đồng tinh luyện để làm đồng lá mỏng ký hiệu HSF-USB3-3.0 được sản xuất như sau:

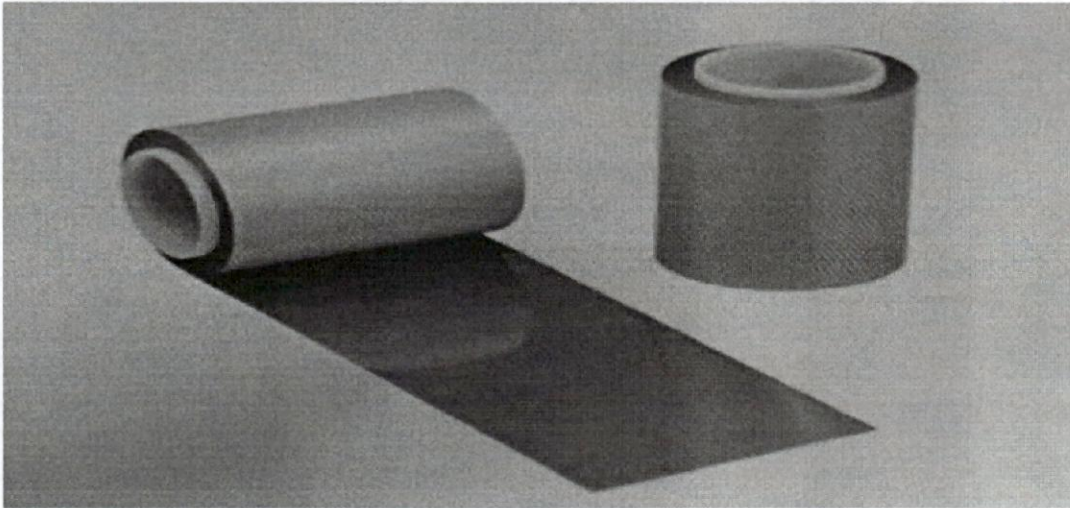
+ Đồng nguyên chất được hòa tan trong axit để tạo ra chất điện phân đồng CuSO_4 và được bơm vào các thùng quay tích điện.

+ Thùng chứa dung dịch điện phân đồng được kết nối với cực dương còn trống quay titan được kết nối với cực âm.

+ Khi đặt 1 điện trường vào, trống sẽ quay với tốc độ chậm, đồng bị hút và tích tụ trên bề mặt cực âm của trống. Bề mặt đồng ở mặt trống nhẵn trong khi mặt đối diện nhám. Tốc độ trống càng chậm thì đồng càng dày và ngược lại.

(2) Công đoạn EMI: Phủ chất chống dính và lớp cách điện màu đen => Phún xạ chân không => Mạ điện phân và công đoạn đặc biệt => Phủ chất kết dính => Cắt và ghép màng bảo vệ => Đóng gói.

- Công dụng theo thiết kế: Tạo tính dẫn điện của bản mạch in điện tử dùng cho các sản phẩm điện tử như: điện thoại, ti vi, máy tính....



(Hình ảnh mặt hàng)

3. Kết quả xác định trước mã số: Theo hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Cục Hải quan xác định kết quả xác định trước mã số như sau:

Tên thương mại: Đồng lá mỏng, bằng đồng tinh luyện, ký hiệu HSF-USB3-3.0.

- Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Theo thông tin công ty cung cấp tại hồ sơ xác định trước mã số về mặt hàng: Đồng lá mỏng (bằng đồng tinh luyện), có bề mặt được làm phẳng, mặt cắt ngang đặc hình chữ nhật, được mạ điện phân niken, được bồi 2 mặt bằng lớp cách điện nhựa epoxy + carbon và lớp keo kết dính epoxy không dẫn điện, 2 lớp phụ là màng nhựa PET để bảo vệ bề mặt trên dưới của sản phẩm khi vận chuyển, chống tác động ngoại lực bên ngoài trong quá trình thao tác sản xuất. Mặt hàng dạng cuộn, kích thước: chiều dày 10 μ m (không gồm lớp bồi nhựa PET), chiều rộng 250mm-200mm, chiều dài từ 10m đến 500m.

Mặt hàng được cấu tạo bởi 03 lớp chính như sau:

(1) Lớp Insulation (lớp cách điện): gồm Epoxy resin chiếm 24,7% và Carbon chiếm 6,1% tính trên tổng trọng lượng, có tác dụng cách điện, bảo vệ bề mặt, không tham gia dẫn điện.

(2) Lớp Metallic (lớp dẫn điện và chắn nhiễu điện từ) gồm Niken chiếm 7,5% và Đồng tinh luyện chiếm 47,1% tính trên tổng trọng lượng, mạ niken có tác dụng tăng độ ổn định bề mặt, tăng khả năng chống ăn mòn, khả năng che chắn, tối ưu hoá độ dẫn điện cho lớp đồng. Đồng tinh luyện lá mỏng có tác dụng dẫn điện cực tốt và chắn nhiễu điện từ cho bản mạch in điện tử.

(3) Lớp Adhesive (lớp keo không dẫn điện): Epoxy resin chiếm 14.6% tính trên tổng trọng lượng, có tác dụng gắn kết, chống ăn mòn, chống ẩm bề mặt và trợ cứng cho lớp đồng lá mỏng khỏi tác động ngoại lực.

Ngoài 3 lớp chính thì có 2 lớp bồi: Protective Film (Lớp bồi mặt trên) và Carrier Film (Lớp bồi mặt dưới), có tác dụng bảo vệ bề mặt khi vận chuyển, trợ cứng cho lớp đồng lá mỏng chống tác động ngoại lực trong quá trình sản xuất..

Mặt hàng khi đưa vào dây chuyền sản xuất được tời ra cho vào mắt cắt và máy dập để cắt dập theo hình dáng kích thước và đặc thù riêng của từng loại bản mạch điện tử. Để sử dụng cần loại bỏ hết bavia, rồi bóc 2 lớp màng PET đi và chỉ giữ lại lớp đồng mạ niken ở giữa, lớp cách điện là nhựa epoxy + carbon và lớp keo kết dính epoxy không dẫn điện, sau đó dán hoặc gắn lên module mặt trước của bản mạch.

Ký, mã hiệu, chủng loại: HSF-USB3-3.0 (EMI Shielding Film)

Nhà sản xuất:
GUANGZHOU FANGBANG
ELECTRONICS CO., LTD (P.R.C)

thuộc nhóm **74.10** “Đồng lá mỏng (đã hoặc chưa in hoặc bồi trên giấy, bìa, plastic hoặc vật liệu bồi tương tự), với chiều dày (không kể phần bồi) không quá 0,15 mm”, phân nhóm “- Đã được bồi”, mã số **7410.21.00** “- - Bằng đồng tinh luyện” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

Cục trưởng Cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Hwaseung Tech Vina biết và thực hiện./. *2k*

Nơi nhận:

- Công ty TNHH Hwaseung Tech Vina (Đ/c: Lô CN02-3, KCN Bình Xuyên II, Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam);
- PCT Nguyễn Thành Hưng (để b/c);
- Chi cục Kiểm định Hải quan;
- Các Chi cục Hải quan khu vực (để t/h);
- Công thông tin điện tử Hải quan (VP);
- Lưu: VT, NVTHQ (PL-NLinh)(3b). *m*

TL. CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN NGHIỆP VỤ THUẾ HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN



Bùi Tuấn Hải

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.